

厦门弘信电子科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门弘信电子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2017】617号）文件核准，并经深圳证券交易所同意，公开发行人民币普通股（A股）2,600万股，每股发行价格为7.77元。截至2017年5月18日止，本公司募集资金总额为人民币202,020,000.00元，扣除发行费用38,016,000.00元后，本公司实际收到募集资金净额人民币164,004,000.00元，已存入本公司在以下银行开设的账户内：

账户名称	开户银行	账号	金额(人民币)元)
厦门弘信电子科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	129380100100192014	164,004,000.00
合计			164,004,000.00

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“致同验字（2017）第350ZA0024号”验资报告。

本公司募集资金到账后，经董事会批准全部用于置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目计164,004,000.00元。截止2017年9月30日，募集资金已全部使用完毕。

二、前次募集资金的实际使用情况

1. 见附件一。

2. 截止2017年9月30日止，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。募集资金164,004,000.00元已经全部投入使用。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目为年产54.72万平方米挠性印制电路板建设项目，未发生过变更。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2017年6月4日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入的自筹资金。截止2017年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币40,212.03万元，置换募集资金投资项目金额人民币16,400.40万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于2017年6月4日出具了《关于厦门弘信电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（致同专字（2017）第350ZA0270号）。2017年6月6日，兴业证券股份有限公司发表了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之专项核查意见》，同意本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。

五、临时闲置募集资金情况

截至2017年9月30日，本公司前次募集资金全部用在投资项目上，累计投入人民币16,400.40万元。除募集资金存放期间产生的利息收入32,793.26元外，无临时闲置募集资金情况。

六、尚未使用募集资金情况

本公司前次募集资金实际投资项目，除募集资金存放期间产生的利息收入32,793.26元外，不存在尚未使用募集资金情况。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1. 见附件二

2. 本公司前次募集资金投资项目为“年产54.72万平方米挠性印制电路板建设项目”，该项目的实施主体是本公司。该项目效益实现过程为：通过卷对卷生产线投入，提高了产能，生产的FPC产品及时满足客户需求，有利于本公司的稳定经营和持续发展。本公司未对该项目的实现效益做出具体承诺。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

本公司无以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

本公司将募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露有关内容逐项对照，未发现存在重大差异的情况。

附件一：前次募集资金使用情况对照表

附件二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

厦门弘信电子科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 25 日

附件一:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 厦门弘信电子科技股份有限公司

截止日期: 2017年9月30日

单位: 人民币万元

募集资金总额: 16,400.40						已累计使用募集资金总额: 16,400.40				
变更用途的募集资金总额: -						各年度使用募集资金总额: 16,400.40				
变更用途的募集资金总额比例: -						2014年: 16,400.40				
						2015年:				
						2016年:				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产54.72万平方米挠性印制电路板建设项目	年产54.72万平方米挠性印制电路板建设项目	16,400.40	-	16,400.40	16,400.40	-	16,400.40	-	2014年末部分产线达到预定可使用状态, 截止目前产能为27.36万平方米, 产能还将进一步扩大。
小计			16,400.40	-	16,400.40	16,400.40	-	16,400.40	-	

附件二：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：厦门弘信电子科技股份有限公司

截止日期：2017年9月30日

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	最近三年承 诺效益	最近三年实际效益			最近三年累计实 现效益	是否达到预计效 益
序号	项目名称			2014	2015	2016		
1	年产54.72万平方米挠性 印制电路板建设项目	不适用	不适用	-	1,298.10	1,870.87	3,168.97	不适用